

BGAボイド解析技術「BGA Pro」

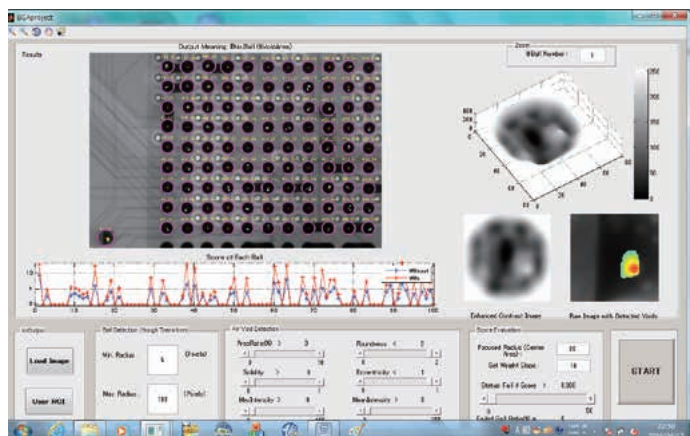
通常のX線透過画像では目に見えないBGA、CSPの画像信号変化を計算処理することで、大きさ、位置を数値化して、半田内部の状態を明確に表示することにより、半田付け解析のアシストをします。

概要

- X線画像から、BGAのボール領域を識別し、目に見えない画像信号の変化を明確に表示するアプリケーションソフトを開発。

適用用途

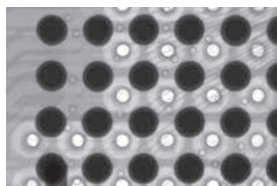
- BGA、CSPのボイド状態などを数値化することで半田付け状態を評価することが出来ます。
- ボイド状態を知ることにより、リフロー等の条件設定の情報として活用できます。



アプリケーションソフト「BGA Pro」

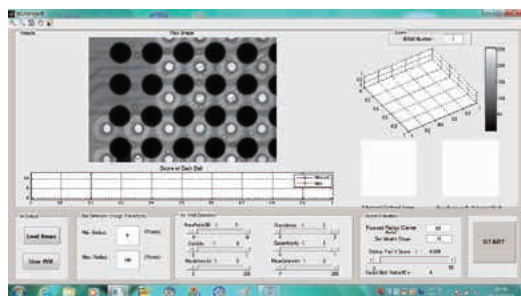
「BGA Pro」によるボイド解析技術

- ボイド解析の流れ



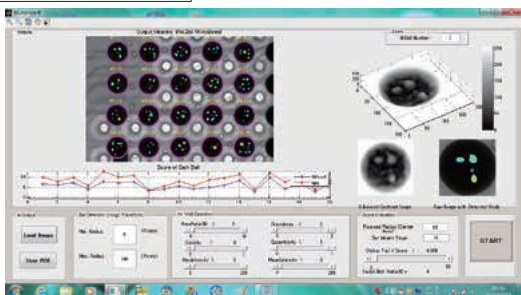
X線画像

X線画像をBGA Proに取り込み

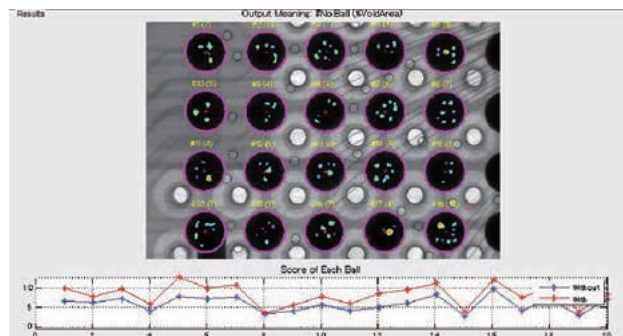


「BGA Pro」

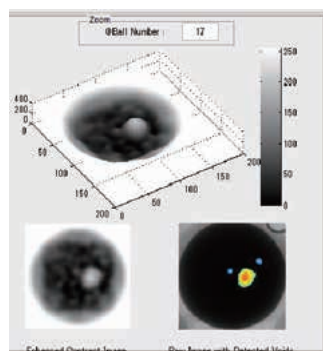
STARTボタンを押すだけでボールを判断し、ボイド状態を表示



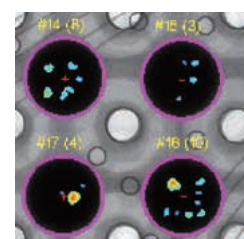
「BGA Pro」



- 折線グラフによりボイド数量(青線)、状態を表示 (ボール中央付近に存在するボイドを赤線で表示)



- 各ボールの詳細を表示
- ボイドの大きさを色で表示



- ボールのボイド数を () 内に表示

【お問い合わせ先】

株式会社ビームセンス
BEAMSENSE CO., LTD.

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-19-16

TEL/FAX: 06-6384-9563 URL: <http://beamsense.co.jp/>

2016.05.27